

2021年9月6日

各 位

会社名 ニッパツ（日本発条株式会社）
証券コード 5991（東証1部）

半導体プロセス部品(半導体製造装置用部品)の生産能力増強に関するお知らせ

ニッパツ(本社・横浜市、代表取締役社長・茅本隆司)は、半導体プロセス部品の生産能力増強の投資をすることといたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 背景

半導体プロセス部品は、神奈川県伊勢原工場と、2年前に新設した長野県宮田工場の2カ所で生産しております。全世界的な半導体供給不足などから、半導体製造装置に使用される当社の半導体プロセス部品の需要も急速に増加しており、当初の見込みに対して大幅に受注が増加する見通しとなりました。今回の投資は中期経営計画を前倒しし、直近の受注増に対応するものです。2021年8月30日にリリースした、金属基板の生産能力増強に関するお知らせの案件とともに、今後大きな成長が見込まれる半導体プロセス部品の分野においても、今後さらなる需要増加を見込んでおり、建屋の増設等、生産能力の拡大を検討しております。

2. 概要

① 対象工場	産機生産本部宮田工場
② 所在地	長野県上伊那郡宮田村5352-6
③ 投資額	4億円
④ 生産品目	半導体プロセス部品
⑤ 着工予定	2021年7月
⑥ 稼働予定	2022年7月

【本件に関する問い合わせ先】

ニッパツ 広報グループ

Tel. 045-786-7513

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 3-10

以上